【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和4年10月17日(2022.10.17)

【国際公開番号】WO2021/054010
【出願番号】特願2021-546549(P2021-546549)
【国際特許分類】
H01L 21/304(2006.01)
C11D 7/32(2006.01)
C11D 7/26(2006.01)
C11D 1/62(2006.01)
C11D 3/20(2006.01)
C11D 3/30(2006.01)
【FI】
H01L 21/304647B
H01L 21/304622Q
H01L 21/304647A
C11D 7/32
C11D 7/26
C11D 1/62
C11D 3/20
C11D 3/30

【手続補正書】
【提出日】令和4年10月6日(2022.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
化学機械研磨処理が施された半導体基板用の洗浄液であって、
アルカリ性を示し、
第１級アミン、第２級アミン、第３級アミン、およびそれらの塩からなる群より選択される少なくとも１種であるアミン化合物と、
キレート剤と、
水と、を含み、
前記アミン化合物の含有量が、前記洗浄液の全質量に対して２５．５質量％以上９０質量％未満であり、
前記水の含有量が、前記洗浄液の全質量に対して１０～６０質量％である、
洗浄液。
【請求項２】
前記洗浄液のｐＨが、２５℃において８．０～１２．０である、請求項１に記載の洗浄液。
【請求項３】
前記アミン化合物の共役酸の第１酸解離定数が７．０以上である、請求項１または２に記載の洗浄液。
【請求項４】
前記アミン化合物が、アミノアルコールを含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の

洗浄液。
【請求項５】
前記アミノアルコールが第１級アミノ基を有する、請求項４に記載の洗浄液。
【請求項６】
前記洗浄液が、２種以上のアミノアルコールを含む、請求項４または５に記載の洗浄液。
【請求項７】
前記アミノアルコールが、アミノ基に対してα位に位置する第４級炭素原子を有する、請求項４～６のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項８】
前記アミノアルコールが２－アミノ－２－メチル－１－プロパノールである、請求項４～７のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項９】
前記洗浄液が、第４級アンモニウム化合物を更に含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項１０】
前記第４級アンモニウム化合物が、非対称構造を有する、請求項９に記載の洗浄液。
【請求項１１】
前記洗浄液が、２種以上の第４級アンモニウム化合物を更に含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項１２】
前記洗浄液が、界面活性剤を更に含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項１３】
前記洗浄液が、２種以上の界面活性剤を更に含む、請求項１～１２のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項１４】
前記洗浄液が、還元剤を更に含む、請求項１～１３のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項１５】
前記洗浄液が、２種以上の還元剤を更に含む、請求項１～１４のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項１６】
引火点を有さない、請求項１～１５のいずれか１項に記載の洗浄液。
【請求項１７】
請求項１～１６のいずれか１項に記載の洗浄液を、質量比で５００～１００００倍に希釈して得られる希釈洗浄液を、化学機械研磨処理が施された半導体基板に適用して洗浄する工程を含む、半導体基板の洗浄方法。